

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

温州宏丰电工合金股份有限公司

(浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号)



2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 使用可行性分析报告

二〇二六年二月

释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

本公司、公司	指	温州宏丰电工合金股份有限公司
浙江宏丰铜箔	指	浙江宏丰铜箔有限公司
宏丰半导体	指	浙江宏丰半导体新材料有限公司
本次发行	指	温州宏丰本次向不超过 35 名特定对象（含 35 名）发行 A 股股票的行为
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
财政部	指	中华人民共和国财政部
税务总局	指	中华人民共和国税务总局
动力电池	指	为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池，具有体积大、容量高、强度高，抗冲击性强的特点，技术要求较高
锂电铜箔	指	在锂离子电池中，作为负极集流体，既充当负极又充当负极电子流的收集与传输体，对锂离子电池的电化学性能有很大的影响，是提高锂离子电池性能的关键材料之一
电子电路铜箔、电子铜箔	指	电子信息产业的基础原材料，用于与绝缘基材压合的一种电子基础材料，集中在三个方面应用：单双面覆铜板（CCL）制作用；多层印制电路板（PCB）用；电器元件电磁屏蔽用
引线框架	指	集成电路的芯片载体，是一种借助于键合材料（金丝、铝丝、铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件，它起到了和外部导线连接的桥梁作用
蚀刻引线框架	指	采用蚀刻工艺生产的引线框架，区别于冲压工艺生产的引线框架，属于比较高端的产品

覆铜板、CCL	指	Copper Clad Laminate，中文全称覆铜板层压板，是由木浆纸或玻纤布等作增强材料，浸以树脂，单面或双面覆以铜箔，经热压而成的一种产品，是电子工业的基础材料，又名基材，主要用于加工制造印制电路板
印制电路板、PCB	指	Printed Circuit Board，中文名又称印刷电路板、印刷线路板，是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，是电子元器件的支撑体、电子元器件电气连接的载体
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

为满足温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“温州宏丰”“公司”或“发行人”）业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金。本次发行募集资金总额不超过 45,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于锂电铜箔及电子铜箔扩产项目和半导体蚀刻引线框架项目。

公司对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金投资计划

温州宏丰电工合金股份有限公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过（含）45,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元				
序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	实施主体
1	锂电铜箔及电子铜箔扩产项目	28,000.00	28,000.00	浙江宏丰铜箔有限公司
2	半导体蚀刻引线框架项目	17,000.00	17,000.00	浙江宏丰半导体新材料有限公司
合计		45,000.00	45,000.00	-

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析

(一) 锂电铜箔及电子铜箔扩产项目

1、项目概况

项目名称	锂电铜箔及电子铜箔扩产项目
实施主体	浙江宏丰铜箔有限公司
项目总投资	28,000.00 万元
项目建设内容	本项目拟建成 6 条锂电铜箔生产线、2 条电子铜箔生产线。
项目建设地点	温州市温州海洋经济发展示范区昆鹏街道远堤路 138 号

2、项目投资概算

本项目总投资金额为 28,000.00 万元，拟使用募集资金 28,000.00 万元。本项目建设投资估算如下：

序号	费用名称	金额（万元）	占比
1	设备购置费	24,955.00	89.13%
2	安装工程费	545.00	1.95%
3	流动资金	2,500.00	8.93%
合计		28,000.00	100.00%

3、项目建设的必要性

(1) 符合公司发展战略，创造新的利润增长点

铜箔项目作为公司战略规划中的重要组成部分，目前正处于产能爬坡和市场深度开发阶段，各项工作正按计划稳步推进，营收规模、客户群体持续扩大。本项目的实施将进一步加快铜箔业务技术研发与产能提升的进程，延伸高附加值产品链条，与现有业务形成战略协同效应，进一步提升公司在高端铜箔领域的规模化供应能力和市场话语权，强化公司整体竞争力，为公司中长期发展注入新动力，并为股东及投资者带来持续且稳定的价值回报。

(2) 提升规模化效应

规模化效应是铜箔行业发展的重要驱动力，一方面，随着产量的提升，相关成本费用得以有效摊薄，规模化效应可有效降低企业单位生产成本，从而提升竞

争力；另一方面，铜箔下游主要客户为动力电池、储能电池及 PCB 生产厂家，其对铜箔供应商的供货能力与稳定性有较高要求，规模体量小的铜箔厂家很难进入优质客户供应链。

截至目前，公司铜箔产能为 10,000 吨，虽然近几年公司铜箔业务产销量逐步提升，但由于规模化效应不强，大客户验证周期较长，公司的铜箔业务销售规模整体较小。通过本项目的实施，公司将扩大生产能力，充分释放铜箔业务的规模效应，有效降低生产成本，提升供货规模和稳定性，更好满足下游客户对供应商的要求。

(3) 补足地区新能源产业链

温州地区新能源产业已经初具规模。比亚迪温州弗迪新能源动力电池项目规划年产能 20GWh。此外，瑞浦兰钧温州新能源制造基地（三期）项目（二阶段）已投产。达产后将形成 24GWh 的电芯制造产能，加上一期二期累计产能可达 50GWh。

大客户通常对原材料供应的稳定性和及时性有较高要求，截至目前，温州地区尚无成规模锂电铜箔生产商，上述新能源电池项目所需的锂电铜箔大部分从温州地区外采购，导致其运输成本较高。本项目的建立实质上构建起了一条敏捷响应、安全可控的近地供应链体系，可实现对核心客户的及时供应、大幅降低其物流与库存成本，并强化产业链协同效率，有助于公司深度嵌入大客户供应链体系，由供应商升级为战略合作伙伴。

本募投项目的实施，有助于促进公司和上述公司的业务合作，补齐温州地区锂电池产业链的关键环节，与上、下游客户形成紧密协作关系，对温州地区新能源产业链具有“强链、补链”的积极作用，创造区域产业协同效应独特优势。

4、项目建设的可行性

(1) 符合国家政策支持

铜箔行业属于国家鼓励和扶持的行业，国家一系列产业政策及指导性文件的推出，为公司所处行业的健康发展提供了良好的政策环境。《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》《铜产业高质量发展实施方案（2025—2027 年）》

等文件提出要加快推广高强高导铜线缆、5G 基站用铜散热器、超低粗糙度铜箔、高精度铜齿轮等高端铜材，同时开展高端压延铜箔等高性能铜合金材料制备技术研发及产业化应用。《鼓励外商投资产业目录（2022 年版）》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》等文件，均将铜箔材料纳入鼓励类产业范围，不仅明确了其作为高性能关键基础材料的重要地位，还为行业发展指明了方向。《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》进一步将铜箔材料归类为“01 数字产品制造业”，凸显其在数字经济核心产业中的角色。工信部在《基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023 年）》中明确提出加快发展高频高速、高密度、低损耗电子电路用铜箔，推动产业高端化转型。

在下游应用领域，我国相继出台多项政策，支持新能源和 PCB 行业的发展。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》《“十四五”现代能源体系规划》《“十四五”新型储能发展实施方案》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》以及《促进汽车动力电池产业发展行动方案》等一系列政策，均强调了新能源汽车、储能、锂电池等行业的重点支持地位。《国家重点支持的高新技术领域目录》《鼓励进口技术和产品目录》《产业结构调整指导目录》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等政策方针，把 PCB 行业相关产品列为重点发展对象；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备，核心电子元器件、关键软件等产业水平。

（2）行业市场空间大

1) 锂电铜箔的市场情况

随着全球新能源汽车渗透率快速提升和储能市场需求爆发，锂电池产业持续高速增长，带动其关键材料锂电铜箔需求稳步攀升。作为电池负极集流体的关键材料，锂电铜箔不仅承担着活性物质的载体功能，更是电子收集与传导的关键介质，其性能直接影响电池的能量密度、循环寿命和内阻表现，铜箔与负极材料接触越充分、导电性越优异，则电池整体性能越佳。

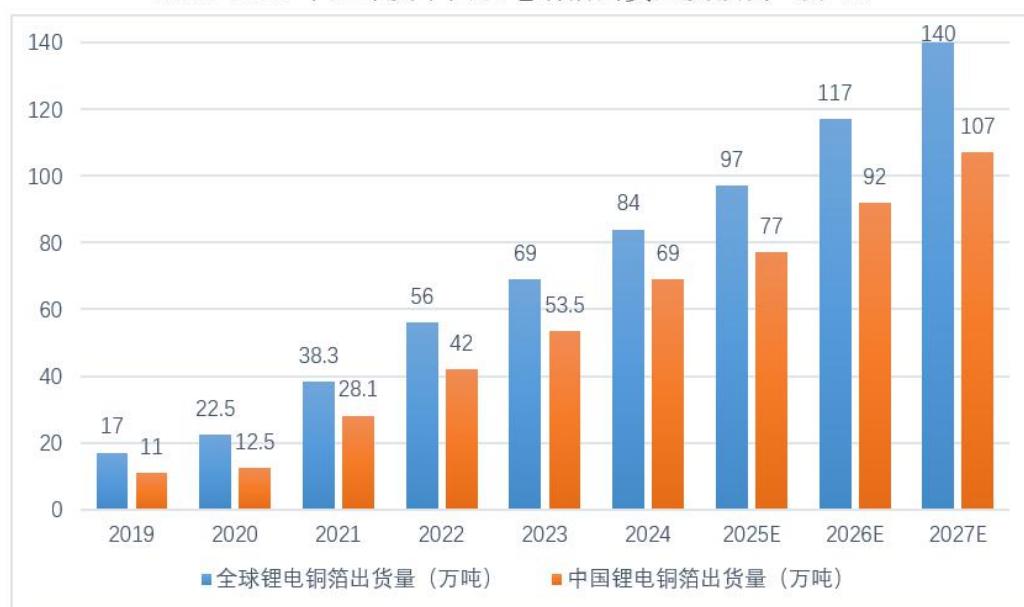
凭借优异的导电性、良好的延展性、成熟的制造工艺以及显著的成本优势，

锂电铜箔已成为当前锂电池负极集流体的首选材料。其中，4-6 微米极薄铜箔因有助于提升电池能量密度、减轻重量并节约空间，正逐步成为高能量密度动力电池的技术主流。公司聚焦于高性能极薄锂电铜箔的研发与生产，精准契合下游电池技术向轻量化、高能效方向发展的核心需求。

根据 EVTANK 统计及预测，2024 年全球锂电池出货量持续上升至 1,545.1GWh，同比增长 28.5%；2030 年全球锂电池出货量预计达 5,127.3GWh，2024-2030 年复合增长率达 22.1%；根据 GGII 统计及预测，2024 年我国锂电池出货量达 1,175GWh，2020-2024 年复合增长率达 69%；2027 年中国锂电池出货量预计达 2,031GWh，2024-2027 年复合增长率仍将保持在 20% 左右。

据高工锂电（GGII）调研统计，2024 年全球锂电铜箔出货量达 84 万吨，同比增长 21.74%；中国锂电铜箔出货量达到 69 万吨，同比增长 28.97%。GGII 预计到 2027 年全球锂电铜箔市场出货量将达 140 万吨，2024-2027 年复合增长率为 18.56%，2027 年中国锂电铜箔市场出货量将达 107 万吨，2024-2027 年复合增长率为 15.75%，展现出强劲的增长潜力。

2019-2027 年全球及中国锂电铜箔出货量及预测（万吨）

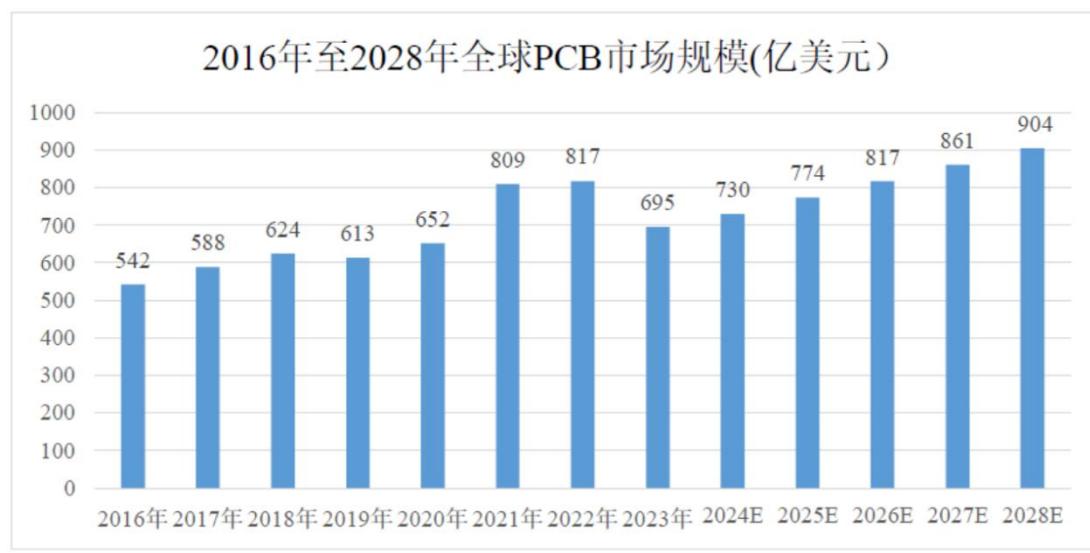


数据来源：高工锂电（GGII）

2) 受益于全球 PCB 市场景气度稳步回升，电子电路铜箔市场规模持续提升
电子电路铜箔的直接下游行业为覆铜板行业。覆铜板是指将电子布等作增强

材料，浸以树脂，单面或双面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，是用于加工制造 PCB 的核心基础材料。电子电路铜箔作为覆铜板（CCL）和印制电路板（PCB）的关键基础材料，广泛应用于 5G 通信、消费电子、汽车电子、通讯雷达、AI 服务器等领域。其一面光亮、一面粗糙的结构设计，确保了与基材的良好结合力及电路信号传输的高效性。随着 5G 基站大规模建设、数据中心扩容和汽车电子化程度提高，高性能 PCB 标箔需求持续上升。

2024 年以来，随着终端库存压力逐渐缓解以及下游消费电子需求回暖，PCB 行业整体景气度有所回暖。AI 服务器及数据存储、高频通信和汽车系统持续强劲的需求将持续支持 PCB 产业链中高端 HDI、高速高频和封装基板等细分市场的快速增长，并为 PCB 行业带来新一轮成长周期，未来全球 PCB 行业仍将呈现持续向好的趋势。Prismark 数据显示 2024 年全球 PCB 产值重启回升，同比增长 5%；2023-2028 年全球 PCB 产值预计年复合增长率达 5.4%，2028 年全球 PCB 产值将达到 904 亿美元，行业发展前景广阔。



数据来源：Prismark

在此背景下，作为 PCB 核心原材料之一的电子电路铜箔也迎来需求上升期。根据中金企信国际咨询《2024-2030 年电子电路铜箔行业发展战略研究及市场占有率评估预测报告》统计，随着 PCB 等产业对电子电路铜箔需求的增长，2024 年、2025 年，电子电路铜箔的需求量分别为 43 万吨、45 万吨，预测到 2030 年中国电子电路铜箔出货量将达 53.80 万吨。

(3) 现有技术储备为项目实施提供坚实基础

作为国内电接触功能复合材料领域的领军企业，公司多年来深耕于金属材料微观结构调控与精密加工工艺，形成了深厚的技术壁垒。这些核心能力在晶粒取向控制、表面界面处理等关键环节与高端铜箔制造具有显著的技术协同性。公司配置了国际一流设备厂商的成套高端产线，可满足高性能铜箔生产要求。随着生产经验的不断积累和工艺的持续优化，产品良率和关键性能指标有望实现阶梯式提升。

铜箔作为新能源电池与高端电子器件的关键基础材料，其质量一致性直接决定终端产品的安全性与效能。公司依托在电接触材料领域深耕多年所积累的质量管控经验，构建了覆盖全生命周期的精细化质量管理体系：从原材料筛选、制程参数实时监控到成品性能验证，实现全链条数字化与标准化管控，确保高端铜箔产品的批次稳定性与可靠性达到行业领先水平。优异的质量管控能力不仅是公司技术可行性的重要组成部分，也是获得高端客户认可的基础。

在技术布局方面，浙江宏丰铜箔拥有授权专利 7 项，另有 6 项专利正在申请中，覆盖铜箔生产工艺、产品性能等多个关键技术领域。此外，浙江宏丰铜箔与浙江工业大学共建“先进铜箔材料联合研发中心”，聚焦锂电铜箔添加剂研发、表面处理工艺优化及 5G 铜箔工艺开发，这一产学研合作机制为公司提供了高校科研力量支持；公司投资 1000 万元设立全资子公司“温州宏丰新材料研究院有限公司”，构建了“研发—中试—产业化”全链条创新体系，布局高性能极薄锂电铜箔、固态电池用铜箔、PCB 用高端电子电路铜箔等领域，为公司持续创新提供坚实的制度保障。

在人才队伍建设方面，公司通过内部培养和外部引进相结合的方式，组建了一支专业的铜箔研发与生产团队，核心技术人员在铜箔生产及应用领域具备深厚经验，能够迅速响应和解决生产过程中的技术问题。人才队伍的持续壮大和结构优化，为公司的技术攻关与创新发展提供了强有力的智力支持。

(4) 公司铜箔生产能力初具规模，客户资源储备丰富

自公司 2022 年进入铜箔行业以来，至 2025 年年底，已顺利完成锂电铜箔一

期项目的建设，成功构建了 1 万吨的产能规模。一期项目的实施，为公司在锂电铜箔行业积累了丰富的生产经验和客户资源。从 2022 年至 2024 年，公司铜箔业务收入逐年增长，分别为 760.27 万元、7,237.66 万元和 15,862.50 万元，呈稳步上升的趋势。公司与动力电池、储能电池和消费电子等多个领域客户等建立了稳固的合作关系，并顺利通过了瑞浦兰钧的供应商认证。一期项目积累的技术储备、生产经验和客户资源，为本项目的开展提供了坚实的保障。

5、项目经济效益分析

经测算，本项目达产后，预计年销售收入 125,970.43 万元，年利润总额 4,336.68 万元，财务内部收益率（税后）为 11.38%。

6、项目审批情况

（1）项目批复或备案情况

截至本报告披露日，本项目备案手续尚在进行中。

（2）环保审批情况

截至本报告披露日，本项目环保审批手续尚在进行中。

（二）半导体蚀刻引线框架项目

1、项目概况

项目名称	半导体蚀刻引线框架项目
实施主体	浙江宏丰半导体新材料有限公司
项目总投资	17,000 万元
项目建设内容	本项目将建设两条镀银引线框架生产线及一条镀金引线框架生产线，达产后将形成半导体蚀刻引线框架年产能约 1,176 万条。
项目建设地点	浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道海鸥路 500 号

2、项目投资概算

本项目总投资金额为 17,000.00 万元，拟使用募集资金 17,000.00 万元。本项目建设投资估算如下：

序号	费用名称	金额（万元）	占比
1	设备购置费	14,505.00	85.32%

2	安装工程费	595.00	3.50%
3	流动资金	1,900.00	11.18%
	合计	17,000.00	100.00%

3、项目建设的必要性

(1) 满足市场需求增长

蚀刻引线框架是先进半导体封装的核心载体材料。在封装材料市场格局中，引线框架以约 15% 的市场份额稳居第二大材料品类，仅次于有机基板。其中，蚀刻工艺凭借微细化加工优势，成为超薄型、高引脚密度引线框架的主流制备方案，特别适用于 QFN/DFN 等高密度集成电路封装场景。虽然目前冲压引线框架应用范围更广，2024 年市场占比高达 67.9%，但蚀刻引线框架凭借 ±5 μm 级高精度和 50 μm 以下超薄成型能力，在 SiP 系统级封装、2.5D/3D 先进封装领域的需求持续增长，当前处于产能紧缺状态。随着终端电子产品持续向轻薄化、高集成度演进，以及人工智能算力芯片、5G 射频模组、车规级功率器件、物联网传感器等新兴应用对半导体器件高性能、高可靠性、微型化的严苛要求，蚀刻引线框架的技术重要性愈发凸显。预计全球半导体引线框架市场将保持快速增长，其中蚀刻工艺占比将持续提升。

根据 SEMI 的数据，2024 年全球半导体材料市场同比增长 3.8%，市场规模约 675 亿美元；其中，封装材料营收同比增长 4.7% 至 246 亿美元。根据 QYResearch 调研，2024 年全球引线框架市场销售额达到 42.95 亿美元，预计 2031 年将达到 55.41 亿美元，2025-2031 期间年复合增长率（CAGR）为 3.8%。

近年来，随着我国封测产业规模不断扩大，长电科技、华天科技、通富微电等均已进入全球封测业十强，且仍在继续扩张中，在国家鼓励半导体材料国产化政策的影响下，国内对引线框架产品的需求将会持续增加。根据观研天下数据，2023 年我国半导体引线框架行业市场规模约为 123.2 亿元，同比增长 7.3%。随着国内整体半导体国产化替代需求持续推动，我国引线框架市场规模将持续向好。

(2) 国内高端产品替代潜力较大

国内蚀刻引线框架领域企业起步较晚，经过多年发展已取得巨大进步，但在高端蚀刻引线框架领域与境外主流厂商仍存在差距。根据集微咨询统计数据，全

球前八大引线框架企业占据约 62% 的市场份额，其中日本三井、长华科技（中国台湾）和日本新光为全球前三大引线框架厂商，分别占据 12%、11% 和 9% 的市场份额。高端蚀刻引线框架领域，中国大陆生产厂商基础较为薄弱，仅有康强电子、新恒汇及天水华洋电子科技股份有限公司等少数企业可以批量供货，国产高端蚀刻引线框架未来发展空间广阔。

（3）符合公司发展战略，提升企业竞争力

公司一直秉持“专注主业、延伸产业链、扩大应用领域”的发展理念。作为公司战略规划的落地措施之一，半导体蚀刻引线框架项目的实施可进一步丰富公司的产品链，提升产品技术水平，优化产品结构，满足客户高端需求，强化综合实力和差异化优势，有利于提升公司的核心竞争力。

4、项目建设的可行性

（1）符合国家政策支持

国家高度重视半导体产业的发展，出台了一系列支持政策，半导体行业的发展促进了上游电子材料产业的协同发展。

2020 年，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，国家鼓励的集成电路材料、封装、测试企业给予财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权等方面优惠政策。

2020 年，财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合发布《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》，国家鼓励的集成电路材料、封装、测试企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

2020 年，发改委、科技部、工信部、财政部联合发布《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》（发改高技〔2020〕1409 号），文件明确了聚焦重点产业投资领域，加快在包括电子封装材料在内的多个领域实现突破。

2021 年 12 月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，强调要增强关键技术创新能力，瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路等战略性前瞻

性领域，提高数字技术基础研发能力。完善 5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。

2024 年 1 月，工业和信息化部等七部门联合制定《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出要推动有色金属、先进半导体等关键战略材料发展，加快超导材料等前沿新材料创新应用。

2024 年 3 月，市场监督管理总局、中央网信办等部门联合制定《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024-2025 年）》，明确在集成电路、半导体材料等关键领域集中攻关，加快研制一批重要技术标准。

2025 年 8 月，工业和信息化部、市场监督管理总局发布了《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》（工信部联电子〔2025〕181 号），通过国家重点研发计划相关领域重点专项，持续支持集成电路、先进计算、未来显示、新型工业控制系统等领域科技创新。

上述政策和法规的发布落实，为半导体行业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，促进了半导体行业的发展，加快了半导体产业的国产化进程。公司建设半导体蚀刻引线框架项目，属于国家政策明确鼓励的先进半导体材料和关键工艺领域，具备坚实的政策支持基础和良好的发展环境。

（2）公司具备工艺技术

引线框架的生产过程需要根据所封装芯片的面积、厚度、功能、引脚布局，相对应的设计出线宽及线距为最小 50 微米的精细电路图案。封装好的芯片在工作时，要通过引线框架的线路与外部其他电子部件进行电信号通讯，以实现芯片的特定功能。引线框架的生产需要在约 0.1 毫米厚度的金属铜合金原材料上，根据设计好的电路图案进行高精度的蚀刻加工。通常采用的技术是利用光刻法，将设计图案转印到金属表面的感光膜上，再通过显影与蚀刻工艺，最终形成所需要的图案。由于刻蚀图案的精度要求非常高，高精度铜箔的表面须具备非常高的洁净度，生产过程中任何尘埃的残留等都可能导致不良品产生，因此引线框架的生产必须在千级洁净车间内进行。

公司在电接触材料领域积累了丰富的材料配方、精密加工和表面处理经验，可为蚀刻引线框架的工艺开发提供关键技术支撑，尤其在材料性能调控、精加工

及质量一致性控制方面具备共通性。依据公司发展战略，基于原有电接触复合材料的技术研发优势，自 2021 年起公司正式进入半导体蚀刻引线框架领域。通过自主研发，公司实现了半导体蚀刻引线框架与电接触复合材料的研发与生产产业链的纵向延伸和技术协同，掌握了多项蚀刻引线框架技术工艺。

卷对卷连续高精度图案蚀刻技术，可以实现在整卷 400 米卷材上的连续生产，同时将图案蚀刻精度控制在 15 微米以内。这不仅保证了连续生产中的速度与对位控制精度，还有效避免了因曝光不足或者过度、蚀刻不足或者过度等问题导致的精细电路出现偏移、变形、断线或粘连等质量缺陷。

公司将卷式无掩膜激光直写曝光（LDI）生产技术成功应用到蚀刻引线框架的生产过程中。相比于传统曝光方式，卷式无掩膜激光直写曝光技术具有显著优势：一方面，生产过程中不需要委托加工高精度掩膜版，不仅有效提升了生产效率，缩短了产品生产和交付周期，同时也避免了环境尘埃落在掩膜版上造成的不良隐患；另一方面，通过激光直接成像曝光后的蚀刻引线框架产品，其图像解析度更高，可达到 20 微米，在行业内处于领先水平。

公司金属表面处理相关技术在业内处于领先地位。在完成高精度图案蚀刻加工后，须对引线框架产品的表面进行复杂的表面处理，使产品能够满足封装或者使用中所要求的特性，主要包括较高的可焊接性、较强的抗腐蚀能力、耐插拔性等。公司成功研发了无模具选择性电镀技术，相较于传统的模具遮蔽选择性电镀技术，该技术具有低成本、快交期、高精度的明显优势。

截至本报告披露日，公司引线框架材料生产基地一期已试生产，实现小批量供货，相关产品已送下游客户试用，通过客户的试用验证后，产品可进入客户的供应链体系。

公司不断加大对电子材料的技术投入和研发力度，本项目的建成并达产，有利于公司在日益激烈的市场竞争环境下提升公司的综合服务能力和水平，扩大生产经营规模和业务渠道，提升产品技术水平，增强公司盈利能力，符合公司战略发展的需要。

5、项目经济效益分析

经测算，本项目达产后，预计年销售收入 16,990.59 万元，年利润总额 2,145.70 万元，财务内部收益率（税后）为 9.11%。

6、项目审批情况

(1) 项目批复或备案情况

截至本报告披露日，本项目备案手续尚在进行中。

(2) 环保审批情况

截至本报告披露日，本项目环保审批手续尚在进行中。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 本次发行募集资金投资项目对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目有利于进一步提升公司综合竞争力，持续优化公司主营业务结构，夯实产品市场竞争力，有效提升公司经营管理能力，进而提升公司盈利水平，增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

(二) 本次发行募集资金投资项目对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产的规模均将有所增加，进一步提高公司抗风险的能力，为公司未来的发展奠定基础。同时，本次发行有利于优化公司的资产负债结构，增强公司偿债能力与抗风险能力，公司的财务结构将更加稳健。

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将有所增加，在资金开始投入募集资金投资项目后，公司投资活动产生的现金流出也将相应增加。未来，随着募集资金投资项目的实施和效益产生，公司的竞争实力将不断提升，公司经营活动产生的现金流量预计将进一一步增加。

本次发行完成后，公司股本总额、资产总额及资产净额将在短期内快速增加，但由于募集资金投资项目具有一定的建设周期，募集资金使用至产生效益需要一定时间，因此公司每股收益、净资产收益率等指标在短期内会出现一定程度的摊薄。从中长期来看，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司业务规模得以进一步扩大，有助于公司提升市场地位与核心竞争力，进而对公司的可持续发展能力和盈利能力起到良好的促进作用。

四、本次募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金投资项目的实施，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2026年2月12日